

日本信頼性学会誌「信頼性」

Vol.46 No.2 2024.3月号

(通巻276号)

目 次

お知らせ	i
目 次	ix
巻 頭 言		
サーキュラーエコノミーをめざして.....	勝田 敬一	35
展 望		
「ダイヤモンド及び超ワイドギャップ半導体の新展開」		
ダイヤモンド材料の開発状況.....	鹿田 真一	36
耐環境型ダイヤモンド半導体.....	梅沢 仁, 金子 純一	42
Si プラットフォーム上ダイヤモンドデバイス集積の実現に向けて	一色 秀夫	49
超ワイドバンドギャップパワー半導体の台頭 — レビュー	木村 忠正	55
解 説		
高温高湿試験データ整理の注意点.....	伊藤 貞則	62
報 告		
日本信頼性学会 2023 年度第 1 回信頼性フォーラム報告	鎗木 俊暁	69
大韓民国信頼性シンポジウム参加報告.....	門田 靖	70
サ ロ ン		
モノづくりにおける安全と安心の関係 —安全・安心の方程式—.....	向殿 政男	73
学会情報		
2023 年度第 5 回理事会（第 287 回日本信頼性学会理事会）議事録	総務委員会	81
会員状況.....	83
編集後記	84
論 文		
トポロジーを開示せずにネットワークの信頼性評価を行う秘密計算法の改善		
.....	畠中 楽, 林 正博	89
広 告		
.....	一般財団法人日本科学技術連盟	vii
.....	大同信号株式会社	viii

The Journal of Reliability Engineering Association of Japan

Vol.46 No.2 March 2024

Content

Preface

Towards a Circular Economy Society Keiichi KATSUTA 35

Special Survey

“New Development of Diamond and Ultrawide Bandgap Semiconductors”

Current Status of Diamond Material Development Shinichi SHIKATA 36

Diamond Semiconductor Devices for Harsh Environments

.....Hitoshi UMEZAWA, Junichi H. KANEKO 42

Toward the Realization of Diamond Device Integration on Si Platform Hideo ISSHIKI 49

Rise of Ultrawide Bandgap Power Semiconductors –A Review Tadamas KIMURA 55

Review

Important Point of Data Organization on High Temperature and Humidity Test Sadanori ITOH 62

Report

Report on 2023 1st Reliability Forum Toshiaki KABURAGI 69

Report on Participation in the Korea Reliability Symposium Yasushi KADOTA 70

Salon

The Relationship between Safety and ANSHIN in Manufacturing —Equation of Safety and ANSHIN—

..... Masao MUKAIDONO 73

From Editor

..... Tadamas KIMURA 84

Paper

An Improvement of Secret Computation for Network Reliability Evaluation without Revealing Topology

..... Raku HATANAKA, Masahiro HAYASHI 89

Published by Reliability Engineering Association of Japan